

높은 열적 특성을 갖는 폴리이미드 필름 제조를 위한 연구

김동영[†]

PI첨단소재

(9ining2out@naver.com[†])

본 논문은 연성금속박적층판으로 적용되는 폴리이미드 필름에 관한 연구 논문이다. 폴리이미드는 최고 수준의 내열성, 전기 절연성, 내화학성의 특징으로 전자 부품의 절연소재로서 각광받고 있다. 일반적으로 많이 알려진 PMDA-ODA의 주쇄는 다른 플라스틱 고분자 필름 대비 높은 열적 특성을 가지지만 금속을 직접 필름 위에 올리는 메탈라이징법에 있어서 낮은 열적 특성을 갖는다. 금속을 직접 필름 위에 올리는 방식의 금속적층판에는 필름의 열적 치수 안정성이 중요하다. 또한 금속이 필름위에 직접 올라가기 때문에 표면 품질이 굉장히 중요하다. 유연한 구조를 갖는 단량체와 강직한 구조를 갖는 단량체의 조합에 따른 열적 치수 안정성이 좋고, 표면 품질이 좋은 필름에 대해서 소개하고자 한다.